

2026年9月15日

各 位

会 社 名 ティアンドエスグループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 武川 義浩
(コード番号:4055 東証グロース市場)

ティアンドエスグループ株式会社と株式会社 TMH、半導体業界向け ソリューション領域における業務提携に関する基本合意書(MOU)を締結

～ハードウェア保守とソフトウェア開発の強みを融合し、現場の課題解決に向けた一気通貫のサポート体制を構築～

ティアンドエスグループ株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、代表取締役:武川 義浩、以下「T&SG」と)と株式会社 TMH(本社:大分県大分市、代表取締役 榎並 大輔(コード番号:280A 東証グロース市場・福証 Q-Board 上場)、以下「TMH」)は、両社の強みを相互に補完し半導体メーカーおよび装置メーカー向けのソリューション提供を目的とした、業務提携に関する基本合意書(MOU)を締結いたしましたので、お知らせいたします。

■ 提携の背景と目的

近年の半導体製造現場においては、製造装置や部材などのハードウェア面での保守メンテナンスにとどまらず、生産性向上や運用効率化に向けたソフトウェア・システム開発へのニーズが急速に高まっています。

T&SGは、製造業やエネルギー分野におけるシステムインテグレーターとして、ソフトウェアの分野からお客様のIT インフラを支えております。特に、大手半導体メーカーを中心に、半導体工場に特化したシステム開発・保守運用ノウハウおよび高い現場知見を有しております。

一方、TMH は、半導体メーカー向けの越境 EC 等を活用した広範な販売チャネルと、ハードウェア領域における豊富な保守・メンテナンス実績を有しております。アフターサービス企業から『半導体製造インテグレーター』へ進化し、半導体工場の「止めない製造」の実現を目指しております。

このたびの両社の業務提携により、TMH が持つ強力な顧客基盤・営業網と、T&SG が有する高度なソフトウェア開発力を融合させ、半導体製造現場の課題をハード・ソフトの両面から一元的に解決する「一気通貫のソリューション」の提供を目指してまいります。

■ 提携・協業の取り組み内容

両社は、段階的な協業深耕により迅速な成果創出と運用定着を図るため、以下のステップにて提携業務を展開してまいります。

1. 第一弾サービス展開(基盤構築と迅速な実績創出)

現場ニーズに即応するため、以下のソフトウェアエンジニア派遣およびシステム保守運用サービスを優先的に展開いたします。

- 既存システムの保守・運用・メンテナンス
- 軽微なカスタマイズおよび機能追加

- 周辺システム(データ連携、可視化、レポート等)の構築・運用
- 常駐・準委任等によるエンジニアリソースの補完

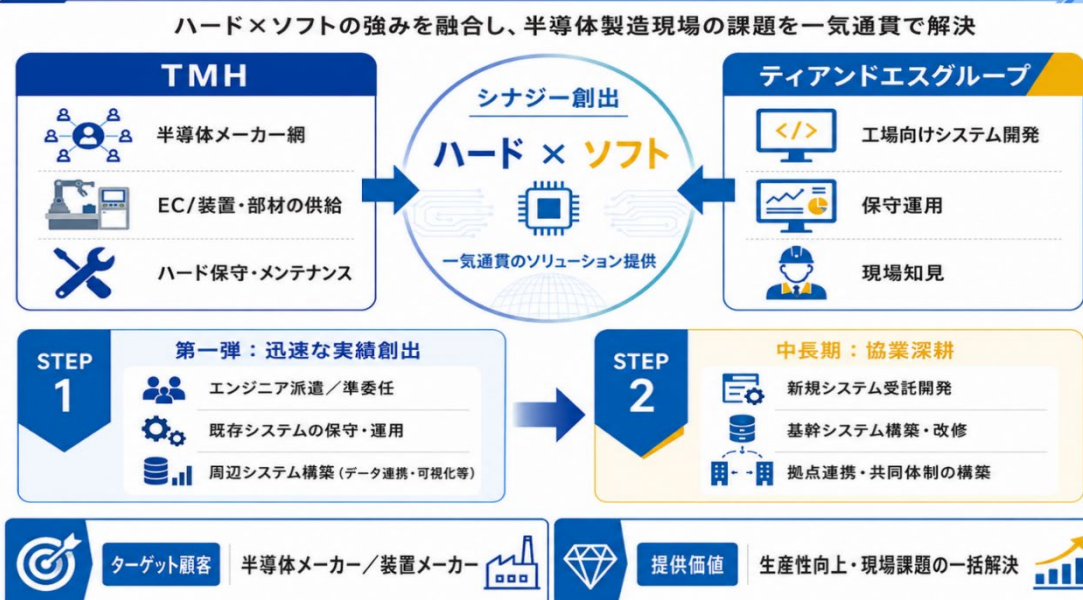
2. システム開発業務全般への拡大(中長期的な協業深耕)

第一弾サービスの運用定着を踏まえ、新規システムの受託開発や基幹システムの構築・大規模改修など、システム開発業務全般へと提携範囲を順次拡大してまいります。

3. 拠点連携および地域対応力の強化

九州や東北地域をはじめとする Fab(半導体工場)集積地域において、両社エンジニアの採用強化および顧客対応力向上を目的とした拠点連携・共同利用についても検討を進めてまいります。

TMH × ティアンドエスグループ 半導体業界向けソリューション領域における業務提携



■ 両社のコメント

ティアンドエスグループ株式会社 代表取締役 武川 義浩

TMH様との提携は、当社のソフトウェア技術や現場知見をより多くの半導体関連企業様にお届けする素晴らしい機会となると確信しております。第一弾となるエンジニア派遣および保守運用サービスから迅速に実績を作り上げ、将来的には大規模システム構築まで見据えた強固な協業関係を築いてまいります。

株式会社 TMH 代表取締役 榎並 大輔氏

当社が培ってきた半導体業界における顧客ネットワークとハードウェア保守の強みに、T&SG様が誇る半導体工場向けの高度なソフトウェア技術力を組み合わせることで、これまで以上にお客様の現場ニーズに深く寄り添ったソリューションが提供可能となります。両社の強みを結集し、半導体産業の持続的な発展に貢献してまいります。

■ 今後の業績に与える影響

本件が当期業績に与える影響は軽微ですが、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせします。

■ 会社概要

【ティアンドエスグループ株式会社】

社名	ティアンドエスグループ株式会社 https://www.tecsvc.co.jp/		
本社所在地	神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-6-3 MM パークビル 11 階		
代表者	代表取締役 武川 義浩	設立:	2016 年 11 月
事業内容	半導体産業領域を含むシステム開発およびその関連サービス事業ほか		
本件に関するお問い合わせ	経営企画 IR 部 E-mail: pr_2@tecsvc.co.jp		

【株式会社 TMH】

社名	株式会社 TMH https://www.tmh-inc.co.jp/		
本社所在地	大分県大分市下郡北 3-14-6		
代表者	代表取締役 榎並 大輔	設立:	2012 年 3 月
事業内容	半導体製造装置部品・メンテナンス事業ほか		
本件に関するお問い合わせ	広報担当 E-mail: tmh.ir@tmh-inc.co.jp		

以 上